半导体国产化- 先进封装&存储展望 20260902

2026H1 存储与封测行业深度分析报告

摘要

- 2026H1 存储价格普涨：NOR Flash 涨 100%-120%，SLC NAND 涨 130%-150%，DRAM 涨 130%-140%，NAND 超 100%。
- 长鑫存储 Q2 毛利率达 80.6%优于海外巨头，净利率 75%，LPDDR5/5X 放量且 LPDDR6 商业化，定价对标海外原厂。
- 模组厂利润弹性最大：江波龙、佰维存储、德明利 H1 合计营收 566 亿，净利 230 亿，毛利率修复至 50%左右。
- 利基存储量价齐升：兆易创新净利 70 亿（+180%），东芯股份 Q2 净利环比增 3 倍，海外原厂退出低端市场驱动供需缺口。
- 封测环节景气分化：AI 服务器拉动 2.5D/3D 封装，通富微电受 AI 算力驱动利润翻倍，长电科技受传统封装占比高影响弹性受限。
- 第三方测试伟测科技 H1 净利增速约 60%，受益于 HPC/AI 测试机台开工率提升，高产能利用率带动利润增速超营收。

Q&A

2026 年上半年全球及国内存储行业的整体市场表现如何，其背后的主要驱动因素是什么？

2026 年上半年，全球存储产业经历了从紧急复苏到超级周期的蜕变。这一趋势主要由两大因素驱动：首先，AI 算力需求呈现非线性爆发；其次，存储原厂在供给端扩产相对谨慎，形成了刚性约束。对于国内厂商而言，在上述背景下还额外叠加了国产替代和市场份额跃升的双重逻辑。综合影响下，国内存储板块上市公司的业绩实现了接近 100%的增长，在电子行业各细分板块中表现最为突出。



各类存储产品的价格涨幅情况，市场对未来的价格走势有何预期？

根据第三方数据，2026 年上半年各类存储产品价格显著上涨。利基存储方面，NOR Flash 合约价累计涨幅约为 100%至 120%，高容量产品涨幅更大；SLC NAND 的累计涨幅在 130%至 150%之间。主流存储方面，DRAM 在第一季度价格上涨约 90%，第二季度上涨 58%至 65%，上半年累计涨幅达 130%至 140%；NAND 的涨幅虽相对较低，也超过一倍。市场预期利基存储的涨价趋势将持续，而 DRAM 价格至少到 2027 年上半年不会出现明显下跌，NAND 价格则有望在高位持续至 2026 年年底。

价格持续上涨对存储产业链中不同类型的厂商（原厂、模组厂、利基厂商）产生了怎样的差异化影响？

价格上涨对产业链各环节的利润改善传导路径有所不同。原厂受益于价格上涨和产能利用率提升的双重弹性，财务报表得到快速修复与增长。模组厂则主要受益于产品涨价、低成本库存的释放以及产品结构升级，利润弹性在三类厂商中最大，但未来面临高价库存管理的挑战。利基存储厂商受益于海外原厂退出部分低端市场，国内厂商通过价格锁定倒逼海外产能出清，从而享有供需缺口带来的量价齐升和毛利率扩张，其盈利增长主要源于产品本身涨价，而非库存价差。

长鑫存储在 2026 年上半年的业绩表现具体如何，尤其是在毛利率和产品结构方面有哪些亮点

长鑫存储 2026 年上半年的业绩超出市场预期，利润规模和毛利率表现均十分亮眼。其第二季度单季毛利率达到 80.6%，这一水平优于海外三大存储厂商。同时，在有效的经营费率管控下，净利率保持在 75%的水平。产品结构方面，长鑫存储消费电子领域持续升级，LPDDR5 和 LPDDR5X 正在放量，LPDDR6 的商业化也出现积极信号。其通用 DRAM 产品定价与海外原厂基本持平，能够充分受益于行业价格高位的红利。

2026 年上半年国内主要存储模组厂商的经营业绩和各自的业务亮点是什么？

2026 年上半年，江波龙、佰维存储、德明利三家主要模组厂合计实现收入约 566 亿元，归母净利润合计约 230 亿元，相较于 2025 年同期的盈亏平衡状态实现了大幅盈利，毛利率普遍修复至 50%左右。 具体来看，江波龙上半年收入 240 亿元，归母净利润超 100 亿元，其企业级存储、自研主控及海外 Lexar 业务均实现明显增长。佰维存储上半年收入 156 亿元，归母净利润 72 亿元，除了存储模组业务，其在 AI 端侧的布局（如 AI 眼镜等新兴终端产品）构成了第二增长曲线。德明利上半年收入 170 亿元，归母净利润 60 亿元，因其前期体量相对较小，业绩弹性表现得更为明显。

国内利基存储厂商的业绩表现，以兆易创新、普冉股份和东芯股份为例，它们的增长特点有何不同？

利基存储厂商的盈利质量和增长斜率相对更为稳定。兆易创新上半年实现收入116亿元，同比增长180%，归母净利润70亿元，扣除非经营性收益后，净利率仍达到40%以上，其DDR4和SLC NAND等产品增长显著。普冉股份上半年收入40亿元，归母净利润12亿元，由于其业务敞口主要在汽车、工业和消费端，增长虽显著，弹性相较其他厂商稍弱，但供需结构更为稳定。东芯股份是利基存储中利润弹性最明显的公司，上半年收入15亿元，同比增长超过3倍，实现净利润6.6亿元；其中第二季度收入环比增长超1倍，净利润环比增长超3倍，表明涨价效应仍在持续兑现至其财务报表。

2026年上半年先进封装行业的景气度呈现出怎样的分化趋势，其核心驱动力是什么？

先进封装行业的景气度主要沿下游应用结构出现分化，核心驱动力源于AI服务器和高性能计算需求的增长。这直接拉动了2.5D、3D及WLCSP等先进封装技术的需求，并进一步向传统封装测试环节传导。因此，业务敞口在先进封装领域的公司业绩弹性更为明显，而那些业务集中于传统封装（如功率器件、传统模拟芯片、DDIC）的公司，其业绩弹性相对较弱，更多表现为产能利用率从低位的恢复。

国内三大封测厂商（长电科技、通富微电、华天科技）在2026年上半年的业绩表现有何差异

三大封测厂商均受益于HPC需求增长及车用、模拟芯片市场的复苏，高端封测收入占比和整体产能利用率均在提升。长电科技上半年收入195亿元，归母净利润8.45亿元，同比增长80%。由于其传统封装业务占比较高，先进封装需求的拉动整体报表端的弹性表现相对有限。通富微电的业绩弹性最为显著，上半年收入同比增长超20%，利润实现翻倍以上增长，是受AI算力需求驱动最直接的封测公司之一。华天科技上半年收入100亿元，同比增长超30%，归母净利润8亿元，同比增长超过两倍，其业绩弹性较大程度上也体现在相对较低的基数上。

除了三大封测龙头，其他在先进封装和第三方测试领域的代表性公司上半年业绩表现如何？

在先进封装领域，甬矽电子上半年收入实现20%的增长，净利润转正至数千万元级别，第二季度收入环比持续增长，但利润端仍受到折旧和新增产能爬坡的压制。在第三方测试领域，伟测科技表现亮眼，上半年收入和利润增速均在60%左右，扣非净利润增速翻倍以上。受益于HPC和AI相关测试需求的提升，其测试机台开工率明显提高，由于测试机台成本相对固定，高产能利用率带来了比收入更快的利润增长弹性。此外，业务与DDIC封装关联度较高的汇成股份，上半年收入实现小幅增长，第二季度单季环比增长30%，显示其主要业务正处于快速需求修

复中。